創辦人：王惕吾　總機：(02)86925588　工商服務及廣告：(02)86433576　客服訂報：0800-666-085　採訪中心：(02)86433562　每份訂價20元

經濟日報

中華民國113年3月18日　星期一　農曆甲辰年2月9日　第20701號　經濟日報網 money.udn.com

民國56年4月20日創刊　社址：新北市汐止區大同路1段369號　承印者：聯合報印刷廠　台灣郵政台字第2267號執照登記為第一類新聞紙類　新聞局登記版台報字第0027號　本報所刊文圖非經同意不得轉載

先進封裝廠 台積大加碼

將砸5,000億在嘉科蓋六座廠 比預期多兩座

1590 雙作帳概念股人氣旺

家上市櫃年報揭露

A13-A14　A12

記者李孟珊、余弦妙／台北報導

台積電嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資案，傳出政院與台積電已有共識，將在嘉科撥出六座新廠用地給台積電，比原本預期的四座多兩座，總投資額逾5,000億元，主要擴充CoWoS先進封裝產能，預計4月上旬對外公布。

對於相關消息，台積電不予回應。政院方面則說，行政院副院長鄭文燦去年中至今年初，就積極協調台積電先進封裝廠進駐位於太保的嘉科，相關環評、水電設施都已盤點、處理完成，預計4月就能動工，間接證實相關傳聞。

消息人士透露，嘉科未來將成台積電先進封裝產能新聚落，六座新廠中，今年會先興建兩座，這與政院透露「4月就能動工」的說法不謀而合。

台積之所以大擴產，主因先進封裝供不應求，以輝達H100爲例，透過CoWoS整合相關元件後，每片晶圓僅能產出約28顆晶片，接下來的B100，因體積與整合度提高，每片晶圓產出量僅剩16顆，預料接下來輝達更新的AI晶片產出量會繼續對折縮減。

隨著輝達每一個新世代AI晶片結合CoWoS後，晶片產出量會以打對折方式銳減，但終端搭載對應輝達AI晶片的AI伺服器卻節節攀高，外資預估2024年H100銷量爲40萬台、B100將增至五、六十萬台，終端需求暴增，但前端產出卻節節下滑，CoWoS先進封裝產能呈現「斷崖式缺口」，台積電須以更快速度補足CoWoS產能，才能確保供應客戶無虞。相關新聞見A3

一周股匯　上市：19682.50 -102.82　上櫃：246.37 -1.06　美股：38714.77 -7.92　台幣／美元：31.593 -0.155　台幣／人民幣：4.410 -0.020